证券简称：*ST金科　证券代码：000656　公告编号：2025-034号

金科地产集团股份有限公司关于公司及控股子公司累计诉讼及仲裁事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

【特别提示】

因司法机关送达流程影响，公司及控股子公司存在未收到、或延迟收到部分法律文书的情况。因本公告涉及部分案件尚在诉讼或仲裁进展过程中，对公司利润金额的影响尚不确定。

公司与重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）的重整申请已被法院裁定受理，根据相关法律法规，有关债务人财产的保全措施应当解除，执行程序应当中止。管理人已向相关法院送达函件，函请其依法中止执行、解除保全。公司将持续密切关注案件进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁情况进行了统计，现将有关情况公告如下：

一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况

截至目前，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司收到的新增诉讼、仲裁案件金额合计13.66亿元（上述诉讼、仲裁的案件涉及金融借款合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、商品房销售合同纠纷、合资合作合同纠纷、劳动争议等类型），占公司最近一期经审计净资产的38.94%。其中，公司控股子公司作为原告起诉的案件涉及金额0.61亿元；公司及控股子公司作为被告或第三人的案件涉及金额13.05亿元（其中包含公司及重庆金科作为被告或第三人的案件涉及金额1.86亿元）。公司及控股子公司收到的新增案件中，进入执行阶段的案件金额合计为0.08亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.23%，详见附件《新增诉讼、仲裁执行案件情况表》。

公司及控股子公司将通过努力谈判、积极应诉等方式推动各项纠纷的解决；同时，受送达流程影响，公司及控股子公司亦存在未收到、或延迟收到相应法律文书的情况。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至目前，公司及控股子公司不存在未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。不存在其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼、仲裁对公司利润金额的可能影响

截至目前，上述诉讼、仲裁案件部分尚在进展过程中，鉴于诉讼或仲裁结果存在较大不确定性，上述案件对公司利润金额的影响尚不确定，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应会计处理。如公司及控股子公司能妥善解决上述案件，存在和解的可能；如未能妥善解决，则公司及控股子公司被诉案件涉及相关资产可能存在被动处置的风险。公司将密切关注案件后续进展，积极做好相关应对工作，依法依规维护公司及全体股东的合法权益，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董　事　会
二〇二五年三月七日

附件：新增诉讼、仲裁执行案件情况表

序号	申请执行人	被执行人	诉讼/仲裁类型	受理法院/仲裁委员会	案号	标的金额（万元）	状态
单笔涉案金额1000万元（含）以上案件							
其中：公司及控股子公司作为申请执行人的案件							
-							
其中：公司及控股子公司作为被执行人的案件							
-							
单笔涉案金额1000万元以下案件							
公司及重庆金科单笔涉案金额1000万元以下案件						-	
除重庆金科外的其他控股子公司单笔涉案金额1000万元以下案件						828.46	执行中

证券简称：*ST金科　证券代码：000656　公告编号：2025-033号

金科地产集团股份有限公司关于公司控股子公司重大诉讼事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

【特别提示】

本次披露的公司控股子公司重大诉讼（仲裁）案件为一审阶段，法院已受理，涉案金额约6.64亿元。案件尚未经法院审理，对公司利润金额造成的影响尚不确定。公司将持续密切关注案件进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、本次诉讼事项的基本情况

公司近日收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院（以下简称“南宁中院”）的《应诉通知书》，获悉原告中国工商银行股份有限公司南宁分行（以下简称“工行南宁分行”）起诉公司控股子公司南宁市新晟金泓房地产开发有限公司（以下简称“南宁新晟金泓”）金融借款合同纠纷一案已被南宁中院受理。

（一）诉讼各方当事人

原告：中国工商银行股份有限公司南宁分行

被告：南宁市新晟金泓房地产开发有限公司（公司控股子公司）

（二）案件概述

原告工行南宁分行与被告南宁新晟金泓签订了《中国银行业协会银团贷款合同》，原告已根据贷款合同向被告发放11笔贷款，共计6亿元。为担保该笔贷款，原告与被告签订了《最高额抵押合同》《抵押合同》《抵押合同补充协议》，被告以其持有的部分不动产为贷款项下形成的债务提供抵押担保，并办理了对应的抵押登记手续。

截至起诉前，被告尚欠原告贷款本金余额约5.87亿元，利息、罚息及复利约0.77亿元，上述金额合计约6.64亿元（暂计至2025年2月5日）。

上述贷款到期日均为2025年1月29日，被告未能按合同约定偿还贷款本息，原告遂起诉至法院。

以上为本案原告诉状中载明的相关内容，案件具体情况以法院查明的事实为准。

（三）原告诉讼请求

1、判令被告向原告偿还贷款本金5.87亿元；

2、判令被告向原告支付利息、罚息及复利合计约0.77亿元（暂计至2025年2月5日）；

3、判令被告向原告赔偿律师代理费5万元；

4、判令本案诉讼费用及其他费用（包括但不限于公告费、财产保全费等）全部由被告承担；

5、为实现上述债权，原告对被告提供的抵押物，有权以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款，在约定范围内优先受偿。

二、诉讼进展情况

案件已经法院受理，尚未开庭审理。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼、仲裁对公司利润金额的可能影响

截至本公告披露日，上述案件尚在进展过程中，鉴于诉讼结果存在较大不确定性，本公告事项对公司利润金额的影响尚不确定。如公司能妥善解决上述案件，则存在和解的可能；如未能妥善解决，则公司被诉案件涉及相关资产可能存在被动处置的风险。公司将密切关注案件后续进展，积极做好相关应对工作，依法依规维护公司及全体股东的合法权益。同时，公司将继续按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、民事起诉状；

2、传票。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董　事　会
二〇二五年三月七日

证券代码：001367　证券简称：海森药业　公告编号：2025-006

浙江海森药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议主持人：董事长王式跃

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年3月7日（星期五）下午14:00

2、网络投票时间：2025年3月7日（星期五）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年3月7日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）召开地点：浙江省金华市东阳市六石街道严店188号综合楼一楼会议室。

（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）出席人员：

1、股东总体出席

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人194人，代表有表决权的公司股份77,399,234股，占上市公司有表决权股份总数的75.3989%。

其中：

通过现场投票的股东及股东代理人12人，代表有表决权的公司股份75,901,000股，占上市公司有表决权股份总数的73.9394%；

通过网络投票的股东及股东代理人182人，代表有表决权的公司股份1,498,234股，占上市公司有表决权股份总数的1.4595%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人183人，代表有表决权的公司股份2,669,950股，占上市公司有表决权股份总数的2.6009%。

其中：

通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表有表决权的公司股份1,171,716股，占上市公司有表决权股份总数的1.1414%；

通过网络投票的中小股东及股东代理人182人，代表有表决权的公司股份1,498,234股，占上市公司有表决权股份总数的1.4595%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如下：

（一）审议通过《关于与东阳经济开发区管理委员会签署＜海森药业新厂区建设项目（一期）投资合作协议＞的议案》

同意77,371,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9647%；反对19,788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256%；弃权7,536股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097%。

其中，中小投资者投票情况为：同意2,642,626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9766%；反对19,788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7411%；弃权7,536股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2823%。

（二）审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

同意77,367,146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9585%；反对19,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0246%；弃权13,048股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169%。

本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案审议通过。

（三）审议通过《关于变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资金追加投资的议案》

同意77,369,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9619%；反对20,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0265%；弃权8,936股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。

其中，中小投资者投票情况为：同意2,640,486股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8965%；反对20,528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7689%；弃权8,936股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3347%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：黄君福、王子安

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江海森药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司董事会
2025年3月8日

证券代码：001367　证券简称：海森药业　公告编号：2025-007

浙江海森药业股份有限公司关于公司竞拍取得土地使用权暨对外投资进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）以人民币9,611.40万元竞拍取得了东阳市自然资源和规划局以挂牌方式公开出让的“东阳经济开发区纵七路以东、横十二路以北”地块，并于2025年3月7日与东阳市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“《出让合同》”）。

本次取得土地使用权相关交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、对外投资事项（含募投项目）进展情况

公司于2024年10月17日分别召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，并于2025年3月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于与东阳经济开发区管理委员会签署＜海森药业新厂区建设项目（一期）投资合作协议＞的议案》，同意公司在东阳经济开发区“万亩千亿”平台生命健康产业园六歌园区内投资“海森药业新厂区建设项目（一期）”（以下简称“新厂区项目”），用于生产硫糖铝和阿托伐他汀钙等原料药，一期项目总投资不低于20亿元人民币。具体内容详见公司于2024年10月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与浙江东阳经济开发区管理委员会签署＜海森药业新厂区建设项目（一期）投资合作协议＞的公告》（公告编号：2024-042）。

公司于2025年2月17日分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，并于2025年3月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资金追加投资的议案》，同意公司变更首次公开发行股票部分募集资金的用途，用于投资建设“年产300吨A-40（阿托伐他汀钙）等特色原料药建设项目”（以下简称“新募投项目”），新募投项目实施地点为东阳经济开发区“万亩千亿”平台生命健康产业园六歌园区，实施方式为购买土地并自建厂房新建生产线，投资总额为41,438.76万元。具体内容详见公司于2025年2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资金追加投资的议案》（公告编号：2025-001）。

根据上述投资项目需要，公司于近期参与了东阳市自然资源和规划局通过浙江省土地使用权网上交易系统以挂牌方式公开出让“东阳经济开发区纵七路以东、横十二路以北”地块的竞拍，以人民币9,611.40万元竞拍取得了该国有建设用地使用权，并于2025年3月7日与东阳市自然资源和规划局签订了《出让合同》。

本次竞拍取得的土地使用权是公司投资建设新厂区项目（含新募投项目）的建设用地。本次签署《出让合同》后，公司将根据有关规定办理相关权属证书及手续。

二、本次竞得土地使用权的基本情况

1、出让人：东阳市自然资源和规划局

2、受让人：浙江海森药业股份有限公司

3、宗地编号：330783202504023023

4、宗地位置：东阳经济开发区纵七路以东、横十二路以北地块

5、宗地总面积：128,152平方米

6、宗地用途：工业用地

7、宗地交付：2025年5月7日前交付

8、出让年期：50年

9、出让价款：人民币9,611.40万元

10、出让价款支付：自《出让合同》签订之日起六十日内全额付清国有建设用地使用权出让价款。

三、本次竞拍土地使用权的目的和对公司的影响

本次竞拍取得使用权的土地位于东阳经济开发区“万亩千亿”平台生命健康产业园六歌园区内，将用于建设“海森药业新厂区建设项目（一期）”项目，包含募投项目“年产300吨A-40（阿托伐他汀钙）等特色原料药建设项目”。本次取得土地使用权，符合公司战略规划及经营发展的需要，有利于进一步扩大公司主导产品的生产规模，完善公司向制剂领域拓展的多元化产品结构；同时，有利于保障公司募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率与投资回报。

本次竞拍的资金来源为公司自有资金，不影响公司现有业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营业绩产生重大不利影响，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次签署《出让合同》后，公司将根据有关规定办理相关权属证书及手续；取得土地使用权后，公司新厂区项目（含新募投项目）的实施尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

公司将积极推进项目建设实施工作，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、《国有建设用地使用权出让合同》。

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司董事会
2025年3月8日

证券代码：688498　证券简称：源杰科技　公告编号：2025-011

陕西源杰半导体科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日召开公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》。同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“10G、25G光芯片产线建设项目”结项，节余募集资金金额为8,258.86万元（含尚未支付的尾款和保证金、利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准），拟将节余募集资金中的8,200万元用于在建募投项目“50G光芯片产业化建设项目”的投资，剩余资金继续用于支付“10G、25G光芯片产线建设项目”的设备尾款和工程款质保金等项目，不足部分，以自有资金支付。

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2022年11月1日出具的《关于同意陕西源杰半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2638号）批准注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000.00股，每股面值1.00元，发行价为每股100.66元，募集资金总额为人民币1,509,900,000.00元，扣除不含税的发行费用131,222,672.46元，公司实际募集资金净额为1,378,677,327.54元。上述资金于2022年12月16日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第ZA16225号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《陕西源杰半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，在扣除各项发行费用后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	10G、25G光芯片产线建设项目	59,075.37	57,000.00
2	50G光芯片产业化建设项目	12,935.63	12,000.00
3	研发中心建设项目	14,313.70	14,000.00
4	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合　计		101,324.70	98,000.00

三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

（一）募投项目结项的具体情况

公司募投项目“10G、25G光芯片产线建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态。截至2025年1月31日，本次结项募投项目的募集资金使用和节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投入总额①	累计投入募集资金总额②	利息及理财收益扣除手续费用后净额③	节余募集资金金额④=①-②+③	预计尚需支付的募集资金金额
10G、25G光芯片产线建设项目	57,000.00	49,527.52	786.37	8,258.86	327.55

注：1、上述“节余募集资金金额”不包含公司尚未收到的银行存款利息收入，系截至2025年1月31日的募集资金余额，实际节余募集资金金额以其对应的专项账户于资金转出日银行结息后的余额为准；

2、“利息及理财收益扣除手续费用后净额”指累计收到的银行存款利息以及使用闲置募集资金现金管理收益扣除手续费等的净额；

3、“预计尚需支付的募集资金金额”包含尚未支付的设备尾款、工程保证金等，其中部分资金用于在建募投项目“50G光芯片产业化建设项目”的投资，剩余部分将继续存放在募集资金专用账户用于支付尾款和保证金，不足部分以自有资金支付，最终金额以项目实际支付为准；

4、所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

（二）本次结项募投项目的募集资金专户存储情况

?本次结项募集资金投资项目为“10G、25G光芯片产线建设项目”，截至2025年1月31日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

项目名称	开户银行	银行账号	账户余额
10G、25G光芯片产线建设项目	中信银行股份有限公司西安分行营业部	8111701012300735584	8,258.86

（三）本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

?“10G、25G光芯片产线建设项目”的预计使用募集资金金额为57,000.00万元。截至2025年1月31日，募集资金已支出金额为49,527.52万元。节余金额为8,258.86万元。主要原因如下：

1、为提高募集资金的使用效率，公司根据市场需求持续调整募投项目的建设规模。市场需求方面，一方面，中、低速率产品需求低于预期，但另一方面，由于AI等的需求拉动，CW等高速率产品的需求大幅增长。为此，公司在产能分配和设备购置方面，适当调低“10G、25G光芯片产线建设项目”投资规模，同时调增“50G光芯片产业化建设项目”投资规模。

2、在募投项目的实施过程中，公司本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金。在募投项目建设和导入期间，为保证项目投资和运营工作的正常推进，部分铺底流动资金需求以自有资金等账户进行支出。

3、在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

四、节余募集资金的使用计划

截至2025年1月31日，“10G、25G光芯片产线建设项目”的节余募集资金金额为8,258.86万元。该部分资金将拟用于以下两部分：

（1）随着终端市场中AI等数据中心的拉动，下游客户对于CW等高速率产品的需求大幅增加，为此，公司将加大“50G光芯片产业化建设项目”的投资。为满足“50G光芯片产业化建设项目”的投资需求，公司拟将“10G、25G光芯片产线建设项目”节余募集资金中的8,200万元用于“50G光芯片产业化建设项目”的投资。

（2）除上述用于其他募投项目的节余资金外，公司将剩余款项继续用于“10G、25G光芯片产线建设项目”的设备尾款和工程款质保金等项目，不足部分以自有资金支付。在“10G、25G光芯片产线建设项目”的剩余款项使用完毕后，办理专用账户的注销手续。前述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的该募集资金专户监管协议随之终止。

五、本次募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目对公司的影响

??本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目，是公司根据募投项目的实施情况做出的审慎决定，符合公司经营的实际情况，有利于公司合理优化资源配置，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的核心竞争力和经营能力，不存在变相改变募集资金投向的情形，有利于公司的长期发展规划及全体股东的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

经审议，监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，符合公司经营的实际情况，有利于公司合理优化资源配置，提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司总体战略规划，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求，不存在损害公司和其他中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目事项无异议。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
2025年3月8日

证券代码：688498　证券简称：源杰科技　公告编号：2025-012

陕西源杰半导体科技股份有限公司关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金和节余募集资金增加募投项目投资额并调整募投项目实施进度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日召开公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金和节余募集资金增加募投项目投资额并调整募投项目实施进度的议案》和《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》。同意拟使用部分超募资金27,500万元和其他募投项目结项后的节余资金8,200万元增加募投项目“50G光芯片产业化建设项目”（以下简称“本项目”）的投资额，并将本项目达到预定可使用状态的时间从2025年12月末调整至2026年12月末。

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2022年11月1日出具的《关于同意陕西源杰半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2638号）批准注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000.00股，每股面值1.00元，发行价为每股100.66元，募集资金总额为人民币1,509,900,000.00元，扣除不含税的发行费用131,222,672.46元，公司实际募集资金净额为1,378,677,327.54元。上述资金于2022年12月16日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第ZA16225号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金使用情况

（一）募投项目情况

截至2025年1月31日，公司募投项目及募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	已累计投入募集资金金额	达到预定可使用状态日期
1	10G、25G光芯片产线建设项目	59,075.37	57,000.00	49,527.52	2024年12月
2	50G光芯片产业化建设项目	12,935.63	12,000.00	9,325.26	2025年12月
3	研发中心建设项目	14,313.70	14,000.00	3,873.52	2026年12月
4	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	15,000.00	不适用
合计		101,324.70	98,000.00	77,726.30	/

注：“10G、25G光芯片产线建设项目”已于2024年末达到预计可使用状态，尚有未支付的设备尾款、工程保证金等，无新增投资内容。

（二）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额137,867.73万元，其中超募资金39,867.73万元。公司于2024年2月7日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意回购的资金总额为不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），资金来源为部分超募资金及自有资金。其中，超募资金为4,500万元，剩余为自有资金。

截至2025年1月31日，公司超募资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	项目	金额	备注
1	超募资金可使用金额①	39,867.73	
2	已使用金额②	4,500.00	
3	利息收益扣除手续费③	1,294.30	
4	剩余募集资金④=①-②+③	36,662.03	

（三）节余募集资金使用情况

公司募投项目“10G、25G光芯片产线建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，节余募集资金金额为8,258.86万元。公司拟将“10G、25G光芯片产线建设项目”节余募集资金中的8,200万元用于“50G光芯片产业化建设项目”的投资。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2025-011）。

三、本次调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金和节余募集资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的具体情况

（一）本次调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金和节余募集资金增加募投项目投资额的具体情况

1、原募投项目计划投资和实际投资情况

??本次拟使用部分超募资金和节余募集资金增加投资额的募投项目为“50G光芯片产业化建设项目”，调整前本项目计划投资12,935.63万元，计划使用募集资金12,000万元。截至2025年1月31日，本项目累计使用募集资金9,325.26万元，剩余未使用资金为2,963.74万元。

单位：万元

序号	项目	金额	备注
1	调整前计划总投资	12,935.63	
2	调整前计划募集资金投入总金额①	12,000.00	
3	募集资金使用金额②	9,325.26	
4	利息收益扣除手续费③	289.01	
5	剩余未使用金额④=①-②+③	2,963.74	

2、本次?调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金和节余募集资金增加募投项目投资额的情况

?本次拟将本项目的总投资额由12,935.63万元调增为48,714.41万元。主要系为满足产能增长的需求，增加了设备投资以及建筑和安装工程费。具体调整情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	调整前金额		调整后金额	
		金额	占比	金额	占比
1	建筑和安装工程费	4,604.27	35.59%	9,285.52	19.06%
2	设备购置费用	6,763.00	52.28%	37,511.47	77.00%
3	基本预备费	568.36	4.39%	1,917.41	3.94%
4	铺底流动资金	1,000.00	7.73%	-	-
合计		12,935.63	100.00%	48,714.41	100.00%

注：所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

3、调整后募集资金使用金额和安排

本项目的资金来源主要为募集资金，调整后计划使用募集资金总金额为47,989.01万元。主要包括以下部分：

（1）截至2025年1月31日，本项目已累计使用募集资金9,325.26万元，此外，现有剩余未使用金额为2,963.74万元；

（2）其他募投项目节余募集资金转入金额为8,200万元，系“10G、25G光芯片产线建设项目”结项时转入的节余资金；

（3）计划使用超募资金金额为27,500万元。

单位：万元

序号	项目	金额	备注
1	调整后计划总投资	48,714.41	
2	调整后计划募集资金投入总金额①=②+③+④+⑤	47,989.01	
3	募集资金已使用金额②	9,325.26	
4	募投项目现有剩余未使用金额③	2,963.74	
5	其他募投项目节余募集资金转入金额④	8,200.00	
6	计划使用超募资金金额⑤	27,500.00	

（二）调整募投项目实施进度的具体情况

因“50G光芯片产业化建设项目”的投资规模的增加，为保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，本项目投资进度有所调整，具体调整情况如下：

序号	项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	50G光芯片产业化建设项目	2025年12月	2026年12月

四、本次募投项目增加投资及继续实施的必要性及可行性

（一）项目实施的必要性

近年来，在全球算力设施建设进程加速的背景下，数据中心的需求与升级持续深化，带动数据传输量的爆发式增长，进而推动全球光模块及光芯片市场规模的快速增长。根据LightCounting的报告，AI对光连接的需求依然强劲，预计2025年以太网光模块的销售额将增长50%。公司需要把握光芯片市场的发展契机，密切关注市场需求的发展动态，持续加强市场开拓力度，以自主光芯片核心能力构建的技术实力为驱动，积极拓展下游客户，提升公司市场竞争力。

此外，随着光通信技术的快速发展，光模块正朝着更高的速率、更小的体积和更高的集成度演进。这一趋势直接推动了光芯片技术的快速迭代升级。因此，高速率光芯片产品迭代速度加快，需求快速增长，公司需要提升高端光芯片的生产能力，以满足客户对多样化产品的需求，确保产品供应的稳定性和高效性，以应对不断加剧的市场竞争和持续增长的客户需求。

（二）项目实施的可行性

1、坚持“柔性、兼容”的产线，满足市场多样化需求

随着人工智能技术的飞速发展、电信市场技术的代际发展，以及新兴应用场景的快速崛起和广泛应用，光芯片技术的迭代升级不断加速。为了更好地满足市场对光芯片产品快速升级以及多样化的需求，公司在本项目生产线设计方面，坚持“柔性、兼容”的设计原则，在生产线设计方面进行通用性设计。本项目生产线能够兼容100G、CW光源等多种高速率光芯片的生产标准要求，确保了公司在面对不同产品需求时能够灵活调整生产工艺，快速响应市场变化，从而在激烈的市场竞争中保持领先地位，为客户提供高质量、高性能的光芯片产品。

2、深厚的技术积累优势，为本项目实施提供充分的技术支持

作为国家高新技术企业，公司自成立以来一直专注于光芯片领域，始终以市场需求为导向，以产品创新为重点，并持续关注国内外市场发展的最新动态，积极开展技术创新，不断研发能满足客户需求的新产品，促使公司技术与产品始终处于行业领先地位。

在技术研发体系方面，公司建立了多层次的研发管理体系，培养了大批基础扎实、技术一流的芯片设计及制造的工程技术人员，同时不断吸纳高质量人才的加入，不断提升技术团队的自主创新能力和技术水平。

在技术创新方面，经过长期研发投入、工艺打磨，公司形成了“掩埋型激光器芯片制造平台”“脊波导型激光器芯片制造平台”与“光放大器集成芯片制造平台”三大平台，积累了“高速调制激光器芯片技术”“异质化合物半导体材料对接生长技术”“小发散角技术”“集成式光芯片高可靠性技术”“大功率激光器高可靠性技术”等十一大技术，持续推动公司的产品不断升级。

在技术成果转化方面，公司已推出高速EML、大功率激光器产品，包括单波及波分等各类方案，以满足下游客户各种类型的模块需求，让光芯片形成性能与可靠性兼备的竞争优势。同时，公司已开发出满足大功率、低色散、高速调制等场景需求的集成技术与光放大器集成技术平台，使得公司光纤接入市场的光芯片产品具备更强的市场竞争力。

综上，公司建立了多层次的研发管理体系，形成了丰富的技术转化成果和核心技术储备，拥有强大的技术创新能力，能够为本项目生产产品提供必要的技术支持和保障。

3、成熟的生产管理体系，为本项目实施提供充分的运营支持

公司自成立以来便深耕芯片行业，不断总结在生产过程中所遇到的各种问题，形成了丰富的生产经验，尤其在产品制造、生产管理等方面经验尤为突出，从而为本项目的顺利实施提供了良好的运营保障。

在产品制造方面，公司建立了包含芯片设计、晶圆制造、芯片加工和测试的IDM全流程业务体系，拥有覆盖MOCVD外延生长、光栅工艺、光波导制作、端面镀膜、自动化芯片测试、芯片高频测试等全流程自主可控生产线。IDM模式能够实现光芯片生产的自主可控，迅速应对动态市场需求，并能够有效控制生产良率、周期交付、产品迭代与风险管控等，为项目实施